

## XZIF 両面高密度インターコネク ト (XZIF DS-HD)

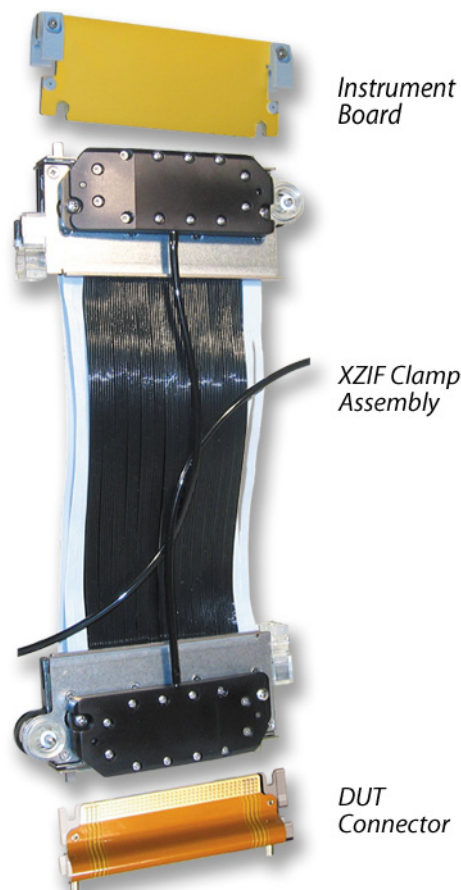
### 第 2 世代高密度 Xandex ゼロ インサーショ ン フォース インターコネク ト (XZIF)

両面高密度 (DS-HD) XZIF インターコネク トは、Xandex 社が開発した第 2 世代の XZIF です。DS-HD XZIF インターコネク トは、単位接触あたりのコストは削減しながら、接触密度を増大させることによりパフォーマンスの向上を図っています。

第 1 世代の XZIF インターコネク トと比較して、DS-HD 電気パスの帯域幅が飛躍的に大きくなり、その電気特性では接触耐久性が 2 倍になりました。

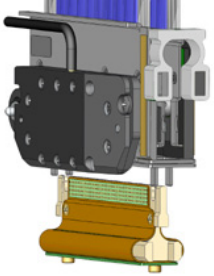
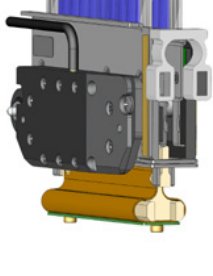
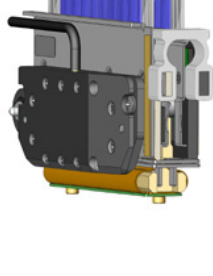
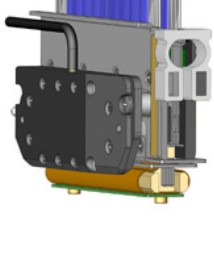
モジュール式 XZIF インターコネク トは、多種多様な検査要件に適合するよう調整することが可能です。これは、揮発性メモリ検査、不揮発性メモリ検査、SOC 検査での使用に最適なソリューションであり、また、DUT に対する動的な大電流伝送にとって理想的です。

また、XZIF インターコネク トでは、接触圧の方向を垂直 (スプリング プローブ) から水平 (クランプ) に変更することにより、DUT 検査ボード上の圧縮力が 90% 近く削減されます。



第 2 世代 XZIF DS-HD インターコネク ト アセンブリ

### XZIF DS-HD インターコネク トのサイクル

			
<p>1) DUT コネクタがクランプ アセンブリに近づきます。</p>	<p>2) DUT コネクタがクランプ とかみ合い、クランプ アセンブリのガイドに沿って位置が調整されます。</p>	<p>3) DUT コネクタがクランプ と完全にかみ合い、位置が完全に合うようクランプで少し圧縮されます。</p>	<p>4) クランプの空気シリンダーが作動し、DUT コネクタがクランプの両側から高圧で圧縮されます。</p>

## Narrow型 XZIF 両面高密度インターコネク ト (XZIF DS-HDn)

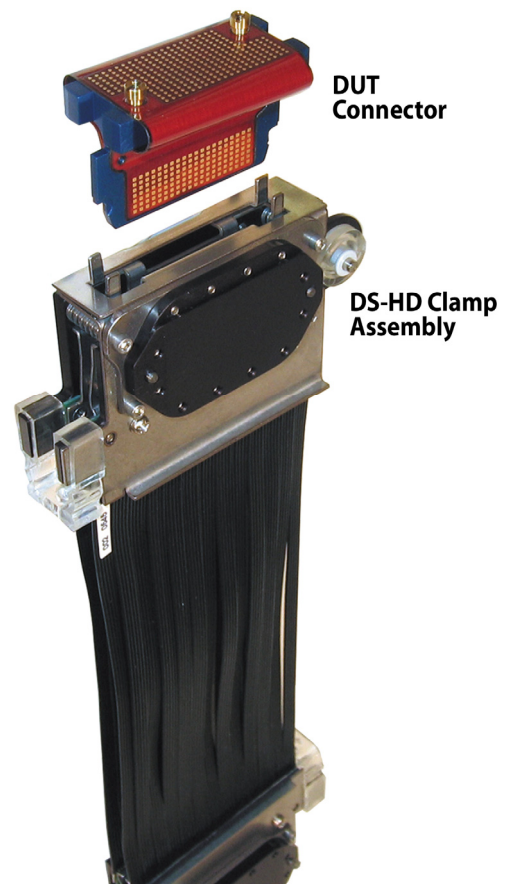
高密度メモリ検査用に Narrow 型フォーム ファクタで登場した高密度 Xandex ゼロ インサージョン フォース インターコネク ト (XZIF)

Narrow 型フォーム ファクタの両面高密度 (DS-HDn) XZIF インターコネク トは、メモリ検査用に Xandex 社が開発した第 2 世代の XZIF です。DS-HDn XZIF インターコネク トは、単位接触あたりのコストは削減しながら、接触密度を増大させることによりパフォーマンスの向上を図っています。

第 1 世代の XZIF フレキシブル インターコネク トと比較して、DS-HDn XZIF では、高密度チャネル対応を目的としたインターポーザ技術と優れた直流接触抵抗を活用しています。

モジュール式 XZIF インターコネク トは、多種多様な検査要件に適合するよう調整することが可能です。これは、揮発性メモリ検査や不揮発性メモリ検査での使用に最適なソリューションです。Narrow 型フォーム ファクタ クランプは、特に、露出部分が大きな小さなプロブ カード (300 + mm) や大きめのプロブ カード (440 + mm) での使用に効果的です。

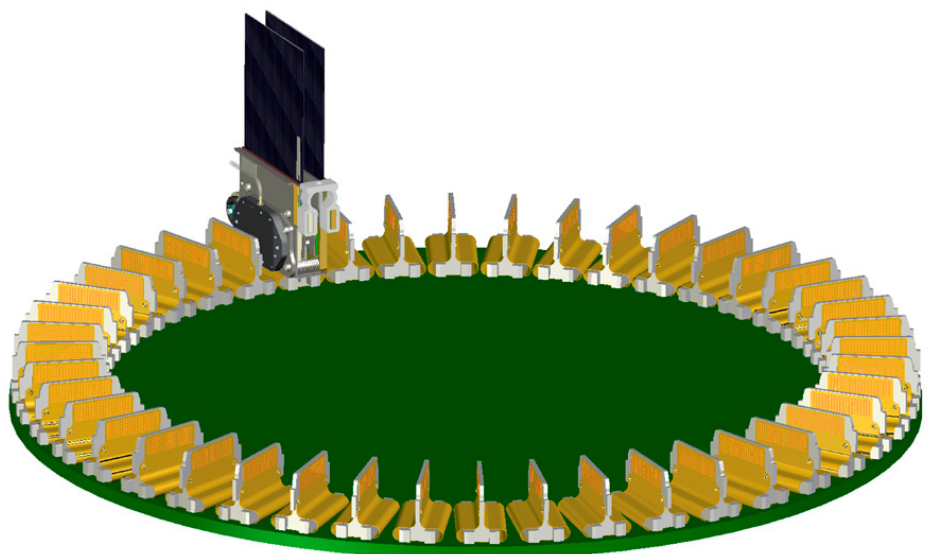
また、XZIF インターコネク トでは、接触圧の方向を垂直 (スプリング プロブ) から水平 (クランプ) に変更することにより、DUT 検査ボード上での圧縮力が 90% 近く削減されます。



第 2 世代 XZIF DS-HDn インターコネク ト アセンブリ

440 mm プロブ カード 1 枚  
あたりの接触: >13,000

XZIF DUT コネクタは、2 本の  
装着ねじにより数分で現場交  
換可能





仕様:

<b>高密度</b>	
1 アセンブリあたりの DS-HD 接触:	344
1 インチ長あたりの接触:	>100
440 mm プローブ カード 1 枚あたりの接触:	>13,000

<b>低いインサージョン フォース</b>	
1 アセンブリあたりの平均圧	5 ポンド [2.3 kg]
1 アセンブリあたりの最大圧	<9 ポンド [4 kg]
13k 接触 XZIF	190 ポンド [86 kg]
13K 接触スプリング ピン (1 ピンあたり 2.2 オンス)	1790 ポンド [812 kg]

<b>高信頼性</b>	
複数ポイントでの接触:	1 接触あたり 12 ポイント
接触ワイプ:	あり
高い通常接触圧:	> 50 グラム
通常の接触抵抗:	<10 mΩ
最大接触抵抗:	10k ライフ以上で < 50 mΩ の接触抵抗

<b>優れたパフォーマンス</b>	
<b>高速構成</b>	
接続性 (1 アセンブリあたり):	132 の同軸チャンネル、および、56 のユーティリティ
-3 dB 帯域幅:	> 4 GHz
インピーダンス制御:	50 Ω ± 2.5 Ω @ 100 ps Tr <sub>10-90</sub>
クロストーク:	<2% FEXT/NEXT @ 500ps Tr <sub>10-90</sub>
<b>高出力構成</b>	
1 アセンブリあたりの電流容量:	325 A
合計ループ抵抗:	< 2 mΩ
合計ループ インダクタンス:	< 500 pH

<b>接触ライフの拡張</b>	
最少接続サイクル数:	10k

<b>保守容易性</b>	
DUT ボード コネクタ:	自動位置合わせボード コネクタは、数分間で現場での交換が可能

